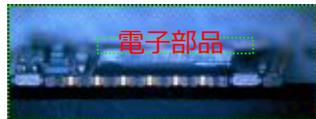


# 半田ボールの断面研磨 - 1

## ①. 電子部品（IC）の単体の半田ボール部断面加工製作事例



## ②. モジュール基板搭載電子部品の半田ボール部断面加工製作事例



- 電子部品が搭載された5層基板
- 側面からは、基板総数と電子部品側面に塗布されたアンダーフィルが観察される。

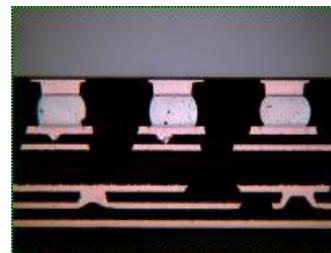


- 電子部品の側面まで研磨し、研磨紙の番数を変え、電子部品への研磨ストレスを軽減する。



- 電子部品と基盤との接続部が現れる。バフ等を使用し仕上げを行う。ボール部は「半田」のため砥粒等が刺さりやすい。

## ③. モジュール基板と搭載電子部品接続部断面



- 目的の観察エリアがでる。半田の接合部は十分な観察が可能。

- 研磨使用ユニット：1軸傾斜ホルダー使用
- 研磨ポイント：ボール面の位置が左右均一また対象になるように仕上げる。
- 観察ポイント：接合部出来栄え・ボール部内部欠陥等